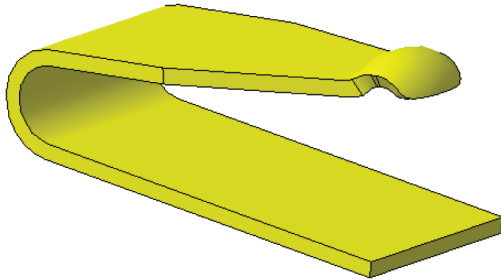


# C-Clip Connector

Pulse Part Number W9908



Ideal for board-to-antenna applications  
Spring contact for positive connection  
Surface mount technology; solder reflowable

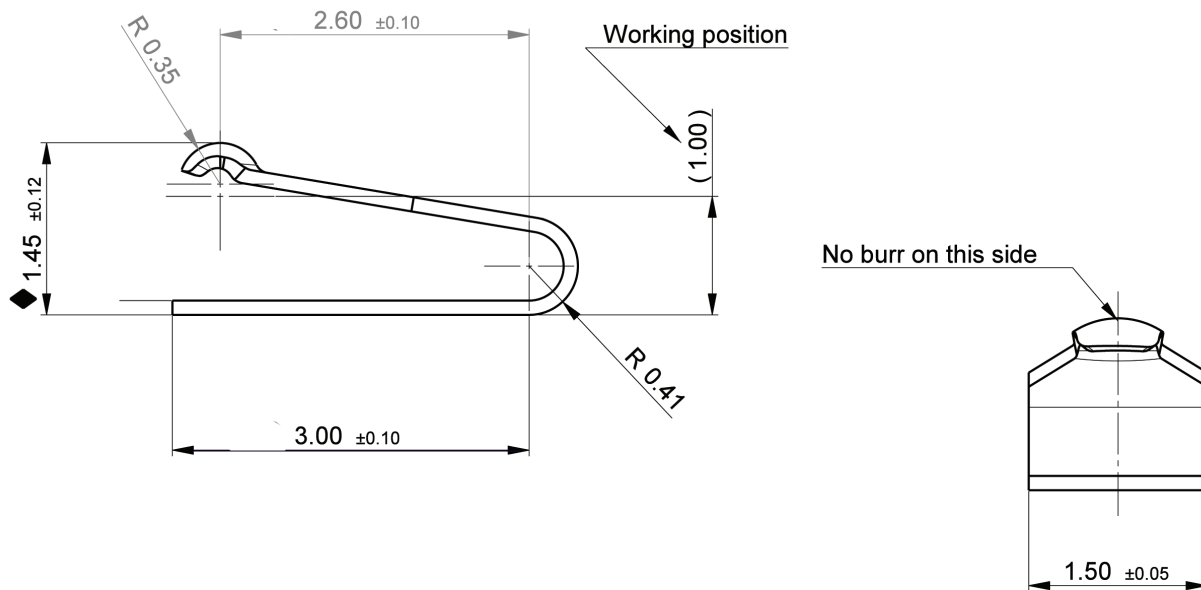


### Features

- PWB Footprint 3.2 x 1.7 mm
- Nominal Contact Height 1 mm
- Tape & Reel Packaging
- RoHS Compliant Product

### Applications

- Antenna Contacts

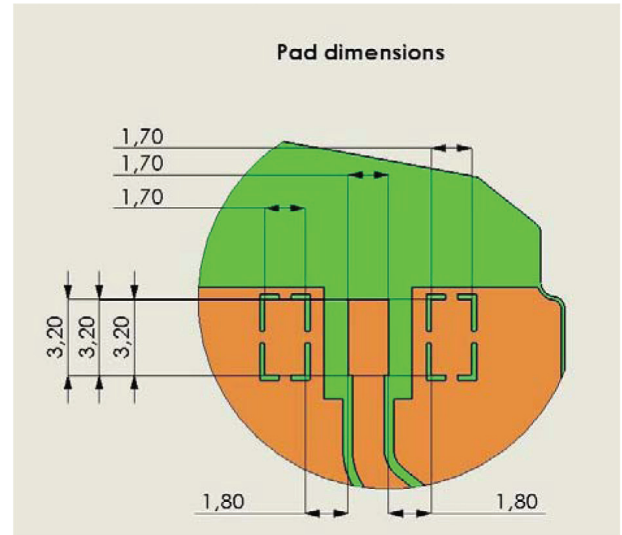
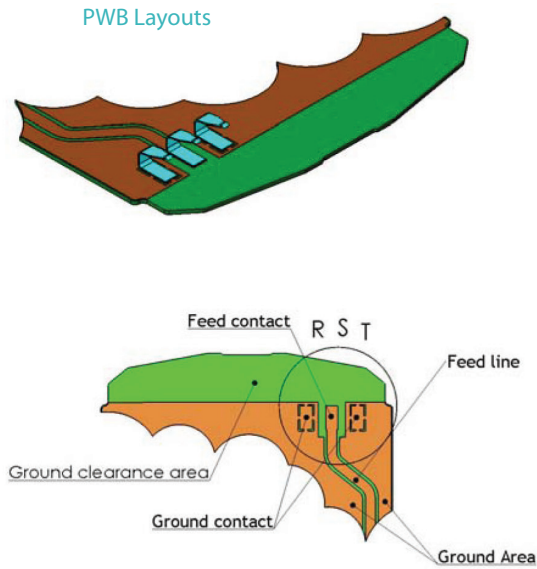


# C-Clip Connector

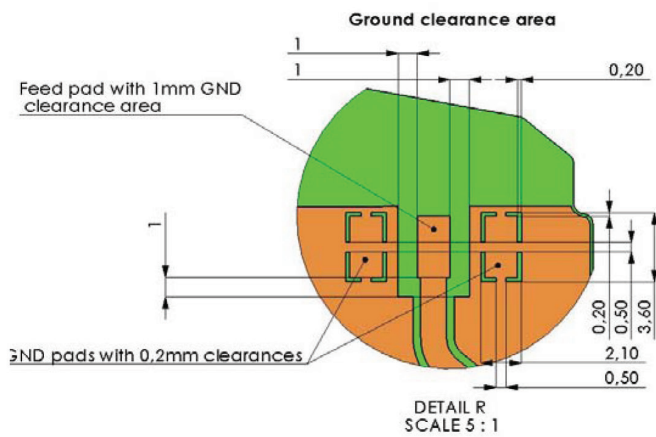
Pulse Part Number W9908

## W9908 C-Clip Configuration and Dimensions

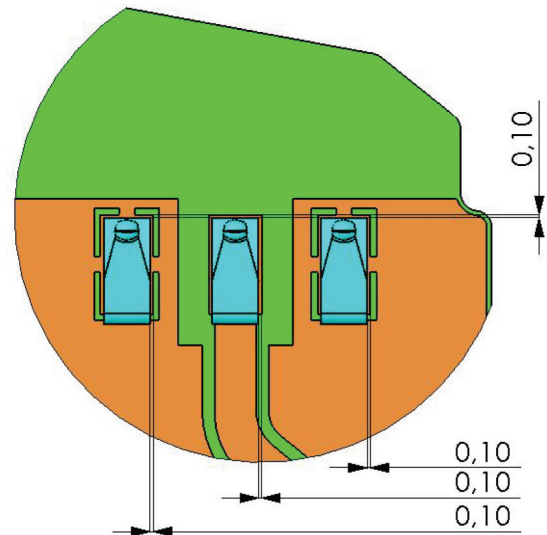
PWB Footprint Dimensions and C-Clip Position for W9908



Ground Clearance Area for W9908 C-Clip



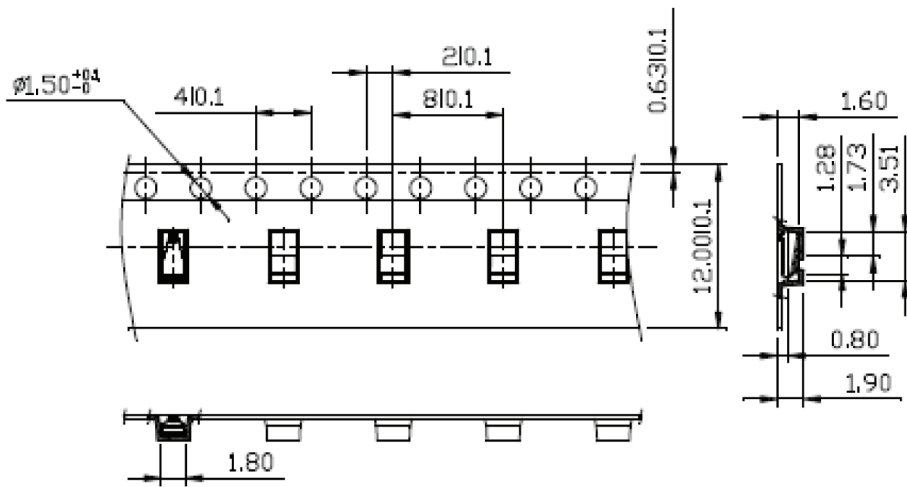
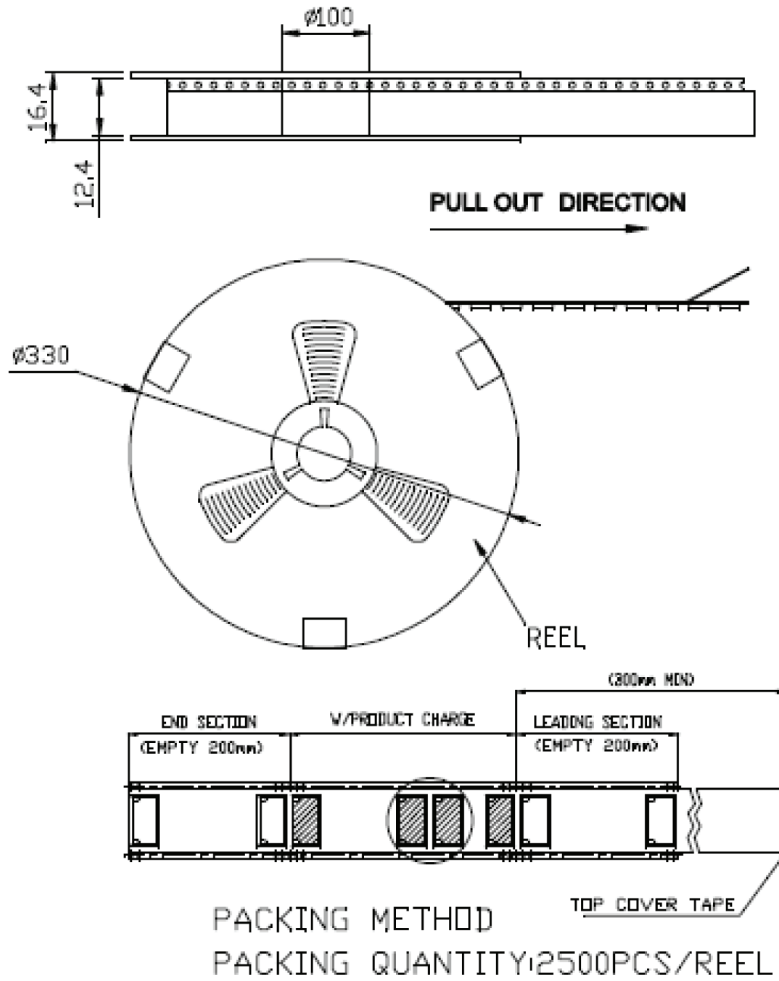
C-clip position on PWB layout



# C-Clip Connector

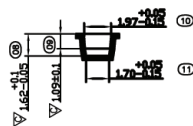
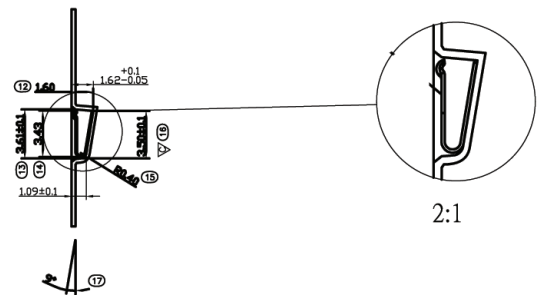
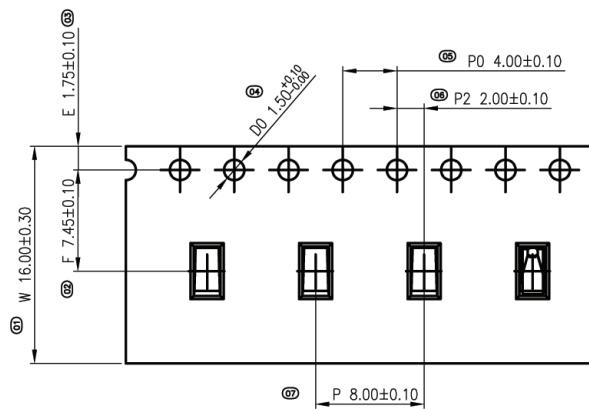
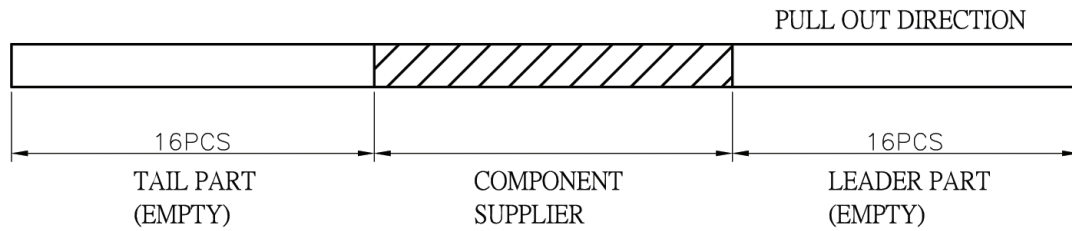
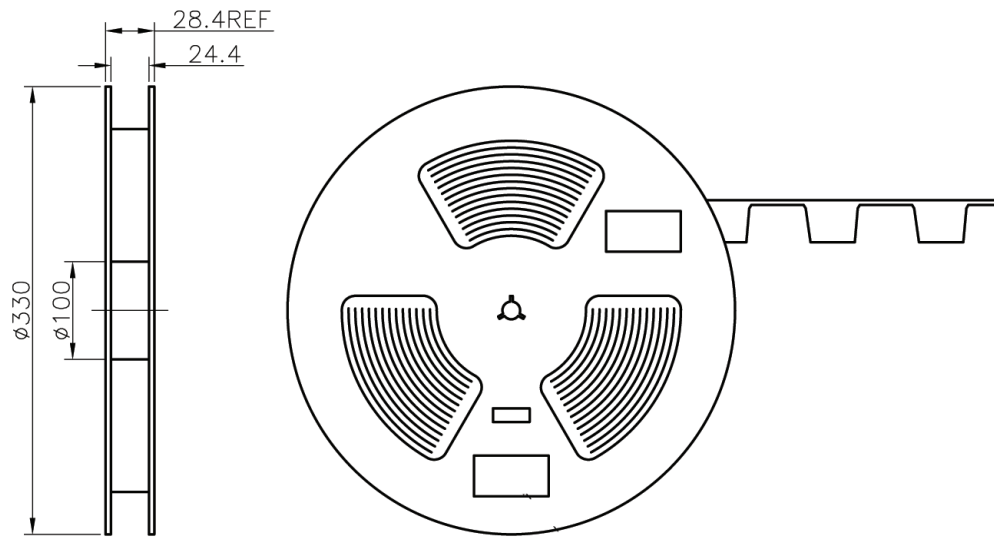
Pulse Part Number W9908

Reel packing:



# C-Clip Connector

Pulse Part Number W9908



# C-Clip Connector

Pulse Part Number W9908

## W9908 Connector Soldering

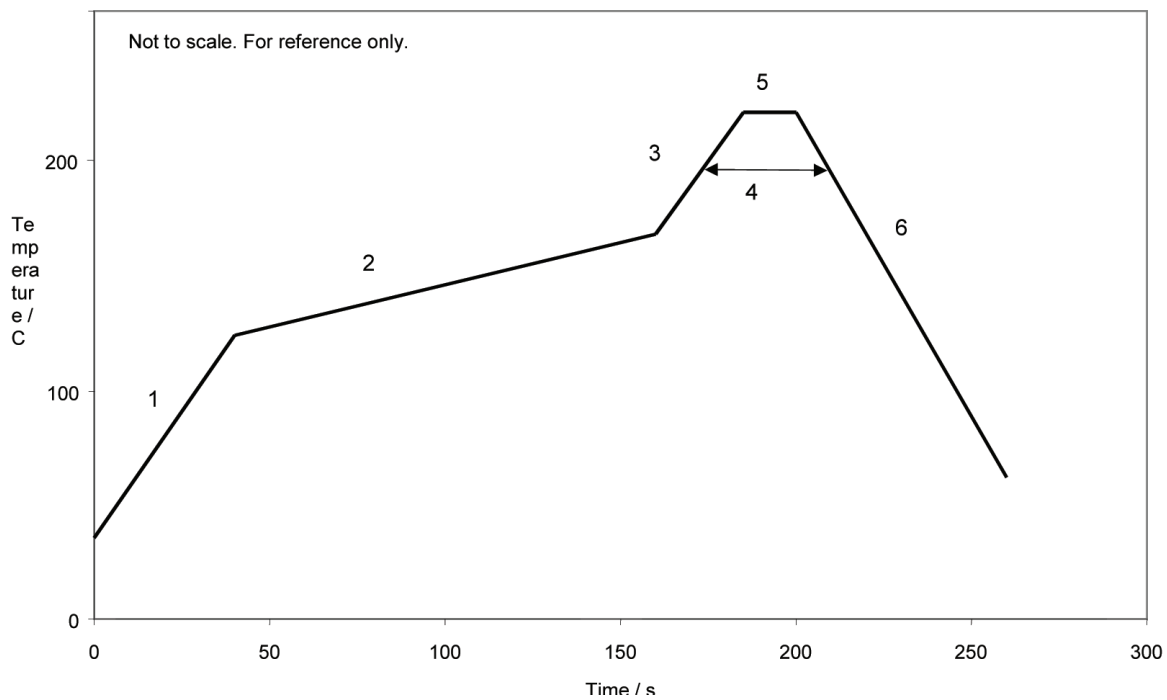
### Recommendation for reflow soldering process

Printing stencil thickness 0.15 to 0.25 mm is recommended for the solder paste. The maximum soldering temperature should not exceed 260°C.

The temperature profile recommendations for reflow solder process are presented in Figure 1 and 2. The reflow profile presented in Figure 2 describes maximum reflow temperatures.

Figure 1 - Minimum temperature profile recommendation for reflow soldering process

	Method of heat transfer	Controlled hot air convection
1	Average temperature gradient in preheating	2.5°C/s
2	Soak time	2-3 minutes
3	Max temperature gradient in reflow	3°C/s
4	Time above 217°C	Max 30 sec
5	Peak temperature in reflow	230°C for 10 seconds
6	Temperature gradient in cooling	Max -5°C/s

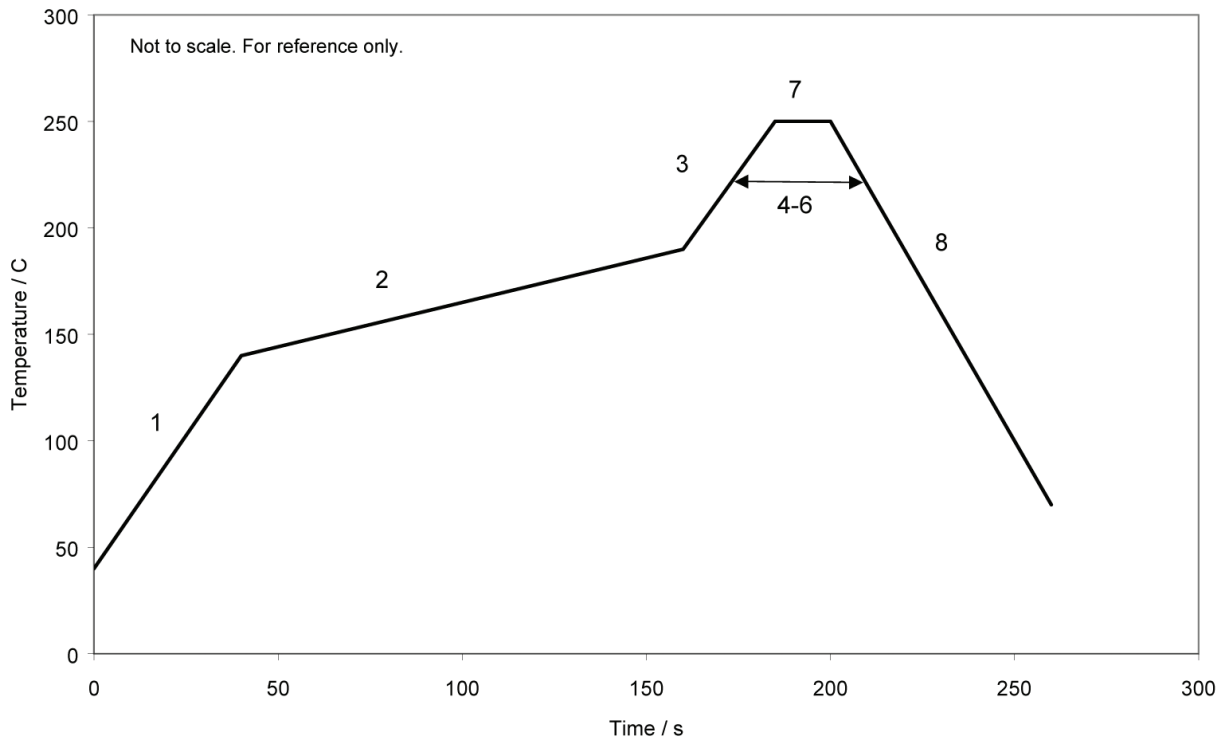


# C-Clip Connector

Pulse Part Number W9908

Figure 2 - Maximum temperature profile recommendation for reflow soldering process

	Method of heat transfer	Controlled hot air convection
1	Average temperature gradient in preheating	2.5°C/s
2	Soak time	2-3 minutes
3	Max temperature gradient in reflow	3°C/s
4	Time above 217°C	Max 60 sec
5	Time above 230°C	Max 50 sec
6	Time above 250°C	Max 10 sec
7	Peak temperature in reflow	260°C for 5 seconds
8	Temperature gradient in cooling	Max -5°C/s



## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9